

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 20251212

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	建信基金：陶灿、华安基金：栾超、华商基金：童立、鹏扬基金：张勋、工银瑞信基金：单文、博时基金：金耀、嘉实基金：杨欢，共 7 名投资者及证券人员
时间	2025 年 12 月 11 日下午 14:30~16:00
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待人员姓名	2025 年 12 月 11 日下午 14:30~16:00: 总经理朱顺全先生、董事会秘书杨平彩女士、投资者关系总监熊亚威先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司介绍:</p> <p>公司是国内领先的关键赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、打印复印通用耗材业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务。此外，在打印复印通用耗材业务板块，公司全产业链布局，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司在该行业内的竞争优势地位。</p> <p>问 1：请问公司抛光液业务在核心技术领域有哪些关键突破？与国内同业相比具备何种技术优势？</p> <p>答：公司深耕半导体材料领域多年，依托有机合成、无机非金属材料、物理化学等七大核心技术平台的协同赋能，在抛光液业务领域构建了深厚的技术壁垒。核心技术突破主要体现在三个方面：一是实现全制程产品布局，全面覆盖介电层、金属层、多晶硅等关键制程用抛光液，其中铜及阻挡层抛光液、多晶硅、金属栅极抛光液等多款高门槛产品已完成技术攻坚；二是攻克核心原材料自主研发难题，成功研发并自主制备超纯氧化硅溶胶、高纯氧</p>

化硅溶胶、氧化铝、氧化铈等四大体系研磨粒子，显著提升产品性能稳定性与成本竞争力；三是突破专利壁垒，构建了完善的知识产权保护体系，成为国内少数具备全流程核心技术的抛光液供应商。此外，公司凭借平台化技术布局，可提供“抛光液+清洗液+抛光垫”一站式 CMP 解决方案，技术协同优势显著，在全制程适配性与定制化服务能力上处于国内领先水平。

问 2：公司对抛光液业务未来 1-2 年的发展有何规划？在技术迭代与市场拓展方面将采取哪些核心举措？

答：未来 1-2 年，公司将继续以技术创新为核心驱动力，推动抛光液业务实现规模化增长与技术升级。技术迭代方面，公司将聚焦全制程抛光液的研发攻关，重点突破高端产品的性能适配性与稳定性问题，同时深化“抛光液+清洗液”产品组合开发，提升一站式解决方案能力；研发投入方面，公司将维持高于行业平均水平的研发强度，2025 年前三季度研发投入已达 3.89 亿元，其中主要投向半导体板块，为抛光液等核心业务技术创新提供充足资金保障。市场拓展方面，公司将进一步深化与国内主流晶圆厂的合作，加速推进多款在测产品的验证落地，力争保持抛光液及清洗液收入持续提升的积极态势。此外，公司将继续完善产能布局，优化生产管理体系，确保产品质量稳定与交付高效，全力打造国内领先的 CMP 材料综合解决方案提供商形象。

问 3：公司抛光液产品在客户端验证进展如何？已进入哪些核心客户供应链体系？

答：凭借优异的产品性能与深厚的技术积累，公司抛光液产品已在国内主流晶圆厂客户中取得突破性进展。目前，多晶硅抛光液与配套清洗液的产品组合方案已获得国内主流逻辑晶圆厂技术认可，并成功斩获“抛光液+清洗液”组合订单；搭载自产氧化铝研磨粒子的金属栅极抛光液已在存量客户端稳定放量供应，同时进入多家新客户研发线导入验证，适配客户端的制程工艺节点需求；搭载自产氧化铈磨料的抛光液产品在客户端导入验证正常推进，反馈情况良好；铜及阻挡层抛光液在已有客户加速导入，同时获得国内多家主流晶圆厂的验证准入资格，进入技术评估阶段。此外，公司抛光液产品已深度渗透国内几家核心晶圆厂供应链，客户认可度持续提升，为后续订单放量奠定了坚实基础。

问 4：请问公司在高端晶圆光刻胶领域已取得哪些核心技术突破？相较于国内同业，核心竞争优势体现在何处？

答：公司深耕进口替代类关键材料领域超 20 年，依托成熟的有机合成、高分子聚合、材料工程化及纯化技术积累，在高端晶圆光刻胶领域构建了难以复制的技术壁垒，核心突破与竞争优势尤为显著。技术突破方面，一是实现全链条自主研发，已具备高端晶圆光刻胶核心原材料（功能单体、主体树脂、含氟树脂、光致产酸剂等）的独立开发能力，实现核心原料环节的自主制备；二是产品矩阵全面领先，已布局近 30 款高端晶圆光刻胶产品，涵盖浸没式 ArF 光刻胶和 KrF 光刻胶，技术指标达到行业领先水平；三是工程化技术成熟，已攻克高端光刻胶生产中严苛的金属离子控制难题，相关关键设备均满足量产标准。公司核心优势体现在“原料自研+配方成熟+产业化经

验”的全链条能力，凭借 OLED 显示用光刻胶、封装光刻胶的开发应用经验及半导体材料的稳定供应经验，快速完成高端晶圆光刻胶产品迭代与客户端导入，此等全链条技术积淀在国内同业中极为稀缺，为公司实现高端光刻胶突破奠定了坚实基础，公司对技术落地与稳定量产成功充满信心。

问 5：高端晶圆光刻胶核心原材料供应情况如何？公司如何保障产业化进程中的原材料稳定供应？

答：核心原材料自主研发是高端晶圆光刻胶产业化的关键前提，公司已构建起稳定可靠的原材料供应体系，完全能够保障产业化进程顺利推进。对于国内有供应商的普通单体，公司采用“采购为主”的模式保障供应；而对于技术壁垒极高、无商业化渠道可购的高端核心单体，公司通过自主合成方式彻底解决供应难题，目前已具备功能单体、主体树脂、含氟树脂等全链条核心原料的自主开发能力，实现自主制备。这种“自主合成+部分采购”的供应模式，既保障了原材料的稳定供应，又通过上下游协同实现了产品性能的精准调控与成本优化。依托超 20 年的有机合成技术积累，公司核心原料自主合成工艺成熟、品质稳定，完全能够匹配高端晶圆光刻胶的生产需求。公司坚信，核心原材料的自主开发能力，将成为推动业务快速产业化的核心竞争力之一。公司将持续聚焦高端晶圆光刻胶的技术迭代与产业化推进，以坚定的决心与扎实的技术实力推动高端晶圆光刻胶进程。

问 6：公司 OLED 显示材料核心产品当前客户端供应及验证进展如何？客户结构是否具备稳定性和拓展性？

答：公司 OLED 显示材料核心产品客户端供应呈现规模化、高增长态势，新产品验证按计划有序推进；客户结构兼具高度稳定性与广阔拓展性，为业务持续增长奠定坚实基础。核心量产产品供应方面，作为 OLED 柔性屏制造核心材料的黄色聚酰亚胺浆料（YPI）、光敏聚酰亚胺浆料（PSPI）是公司该领域的标杆产品，目前已实现全规模稳定供货，且已确立国产供应领先地位，成为国内部分主流显示面板客户 YPI、PSPI 产品的第一供应商。其中，PSPI 产品在仙桃产业园年产 1000 吨的产线已于 2024 年正式投入使用并批量供货，生产体系能力持续提升；YPI 产品则通过武汉本部一期产线保障稳定供应，仙桃年产 800 吨 YPI 二期项目作为新增产能补充，将进一步缓解产能压力以匹配持续增长的订单需求。新产品验证进展方面，无氟 PSPI 产品、黑色像素定义层材料（BPDL）、薄膜封装低介电材料（LowDK INK）、PI 取向液等其他高端显示材料的开发与验证也在持续推进，客户反馈良好。

问 7：公司未来在现有核心业务之外，有哪些新的产品拓展方向？依托何种核心能力保障新领域拓展的成功率？

答：保障新领域拓展成功率的核心能力，源于公司构建的“七大技术平台+四大同步机制+全产业链布局”的平台化体系：其一，公司打造了覆盖有机合成、高分子合成、无机非金属、物理化学等领域的七大核心技术平台，各平台技术可跨领域复用与协同，大幅缩短新领域产品的研发周期。其二，公司坚持“材料技术创新与上游原材料自主化培养同步、与用户验证工艺发展同步、与人才团队培养同步、与知识产权建设同步”的四大同步机制，确

	<p>保新领域产品从研发、中试到量产的全流程顺畅推进，避免出现技术与产业化脱节的问题。其三，公司已建成湖北鼎龙先进材料创新研究院，持续汇聚高端研发人才，近三年累计研发投入超 11 亿元，研发投入占营业收入比例保持在 14% 左右，为新领域技术攻关提供充足资金与人才保障。其四，公司拥有完善的产业化能力与客户资源基础，旗下多家子公司被认定为国家级专精特新小巨人企业，已与国内外主流半导体、显示面板厂商建立深度合作关系，可为新领域产品提供快速的客户端验证渠道与规模化量产支撑。</p> <p>作为平台型材料企业，公司的核心竞争力并非局限于单一产品或单一赛道，而是通过技术平台的复用与升级，实现多领域创新材料的持续突破。未来，公司将继续夯实平台化发展根基，不断拓展创新材料的应用边界，为公司业绩增长开辟更多新的增长曲线。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 12 月 11 日